

作者：金舛轶 来源：新华网 发布时间：2009-4-8 16:50:07

小字号

中字号

大字号

研究人员开发出电子产品快速散热新材料

据柏林媒体4月7日报道，德国弗劳恩霍夫制造工程和应用材料研究所、德国西门子和奥地利攀时集团共同研发了一种新材料，这种材料是在铜中加入掺兑金属铬的钻石粉末，其导热能力是纯铜的1.5倍。

研究人员介绍说，通常情况下钻石和铜是不容易混合到一起的，而在钻石粉末中添加金属铬就能使钻石粉末表面产生一层碳化物膜，这种膜能有效地将二者混合起来。

为使电子元件散热加快，目前常用的方法是在电子元件下安装一块铜板或铝板，但随着电子产品更加小型化和多功能化，铜板、铝板导热能力不足问题日渐突出。研究人员说，新材料满足了小型多功能电子产品快速散热的需要。

发E-mail给: 

打印 | 评论 | 论坛 | 博客

读后感言:

发表评论

相关新闻

- 我国成功研制风电风机叶片关键材料
- 俄研制出飞船外壳“自我修复”新材料
- 周峰小组二氧化钛研究取得新进展
- 中国工程院公布院士增选材料验收有关规定
- 《应用材料与界面》：哈工大研发出新型超级浮力材料
- 《科学》：美研制高强度气凝胶打造机器人肌肉
- 日本用石墨合成晶体颗粒极小的人造金刚石
- 《科学》：科学家发明新涂层能自我修复

一周新闻排行

- “863”项目一科技精英沦为贪官 曾发现非典病毒
- 盘点十大疗效奇特药物 抗忧郁药引发性高潮
- PNAS：猫为何有九条命
- 美国15个品牌婴儿奶粉被检出含高氯酸盐
- 华中科大学生情侣坠楼真相：男生杀害女友后跳楼
- 天文学家拍到猎户座双星系统高精度照片
- 4位华人学者入选HHMI亿元资助
- 清华出走副教授被找到 脱水严重无大碍